

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成25年3月21日(2013.3.21)

【公表番号】特表2010-518649(P2010-518649A)

【公表日】平成22年5月27日(2010.5.27)

【年通号数】公開・登録公報2010-021

【出願番号】特願2009-549743(P2009-549743)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/46 (2006.01)

【 F I 】

H 0 5 K 3/46 L

【誤訳訂正書】

【提出日】平成25年2月1日(2013.2.1)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 2 7

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【 0 0 2 7 】

接着層 15 によって形成された接着によって、回路基板のリジッド部 1 を回路基板のフレキシブル部 7 に接続した後、16 で示されるような分割が、フレキシブル部 7 とは反対側を向くりジッド部 1 の端面から出発して予め形成されたミリング端 14 の領域で実行され、その結果、回路基板の本来的にモノリシック構造のリジッド部 1 の、従って分離されたサブポートまたは部分領域 17、18 が、フレキシブル部 7 を介して接続される。